

開発品 UNDER DEVELOPMENT

COMPACT PACKAGE WITH EPOXY-LENS

レンズ付面実装センサ

COMPACT PACKAGE WITH EPOXY-LENS

 **トップビュー・サイドビュー 実装可能**
TOPVIEW & SIDEVIEW AVAILABLE

リモコン受光モジュール Optical receiver module “ PIC79606 ”

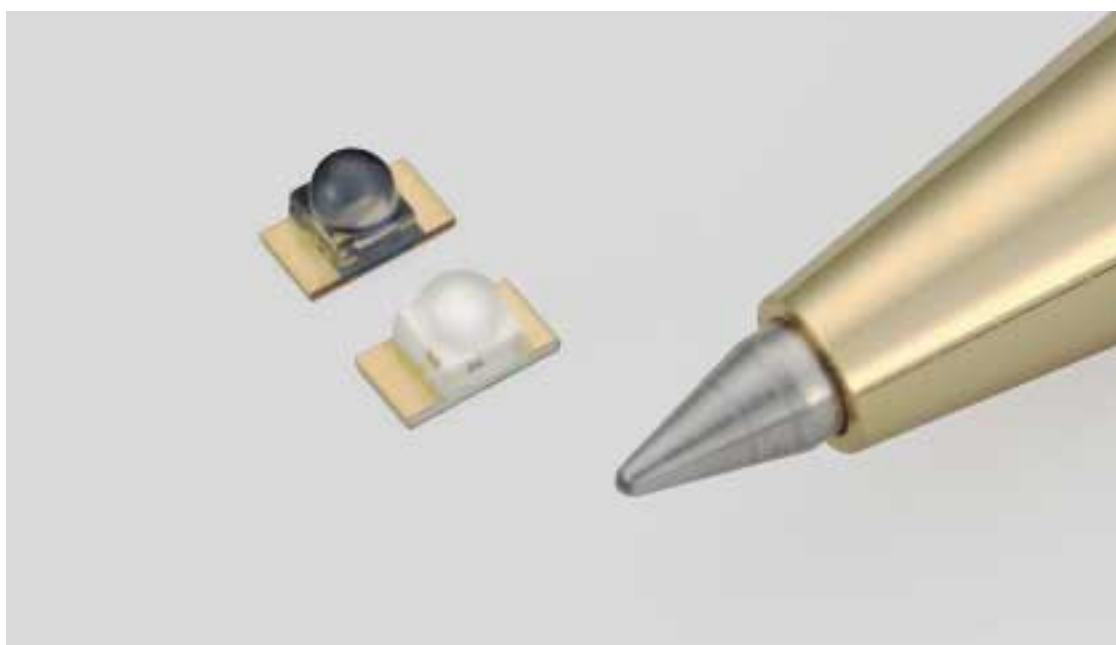


到達距離(従来品比)
/Ultimate distance

50% up

 **回路基板の裏面から実装可能**
Able to solder in the backside of PCB

赤外発光ダイオード Infrared emitting diode “ HL602 ”
高速PINダイオード High speed PINPhotodiode “ HPS602 ”



半値角/Half angle

HL602 : $\pm 5^\circ$
HPS602 : $\pm 20^\circ$